



株式会社UKCホールディングス 2018年(平成30年)3月期第2四半期決算 補足説明資料

2017年11月13日



株式会社 UKCホールディングス



目次



2018年3月期 第2四半期決算(連結)概況

事業セグメント	4
2018年3月期 第2四半期 ハイライト	5
2018年3月期 第2四半期 半導体及び電子部品事業	6
2018年3月期 第2四半期 電子機器事業	7
2018年3月期 第2四半期 システム機器事業	8
2018年3月期 第2四半期 財政状態(バランスシート)	9
2018年3月期 第2四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)	10

2018年3月期 通期連結業績予想

2018年3月期 通期連結業績予想	12
-------------------	----





2018年3月期 第2四半期決算(連結)概況

事業セグメント



事業部門(セグメント)		主要製品	主要顧客／市場
半導体及び電子部品事業	半導体	イメージセンサー、メモリー、マイコン、システムLSI、パワー、その他半導体	エレクトロニクスメーカー
	電子部品	液晶パネル、タッチパネル、バッテリー、光学ピックアップ、ACF、基板、複合部品、その他一般電子部品	
	EMS	電子機器受託製造サービス (Electronic Manufacturing Service)	
	その他	LED照明、太陽光パネル DDS (Dust Detection System) 事業	店舗、工場、オフィス、メガソーラー
電子機器事業	電子機器	各種VTR、カメラ、音響映像関連機器、ビデオプリンター	放送局、プロダクション、一般企業、教育機関、医療機関、半導体製造装置メーカー、システムインテグレータ
	記録媒体品	磁気テープ、光ディスク、データ記録用ディスク	
	製品	電子機器を組み合わせたシステム製品、セキュリティ関連製品	
	その他	電子機器の修理、AV機器のレンタル、教育用ソフトウェア	
システム機器事業	産業電子機器及び伝送端末機器	非接触ICカード(FeliCa, NFC)R/Wモジュール、電子決済端末、出入管理端末	電子決済市場、デジタルサイネージ市場、PC・タブレットメーカー
	その他	信頼性試験受託業務、環境物質分析受託業務	半導体・部品メーカー、太陽電池メーカー



2018年3月期 第2四半期 ハイライト

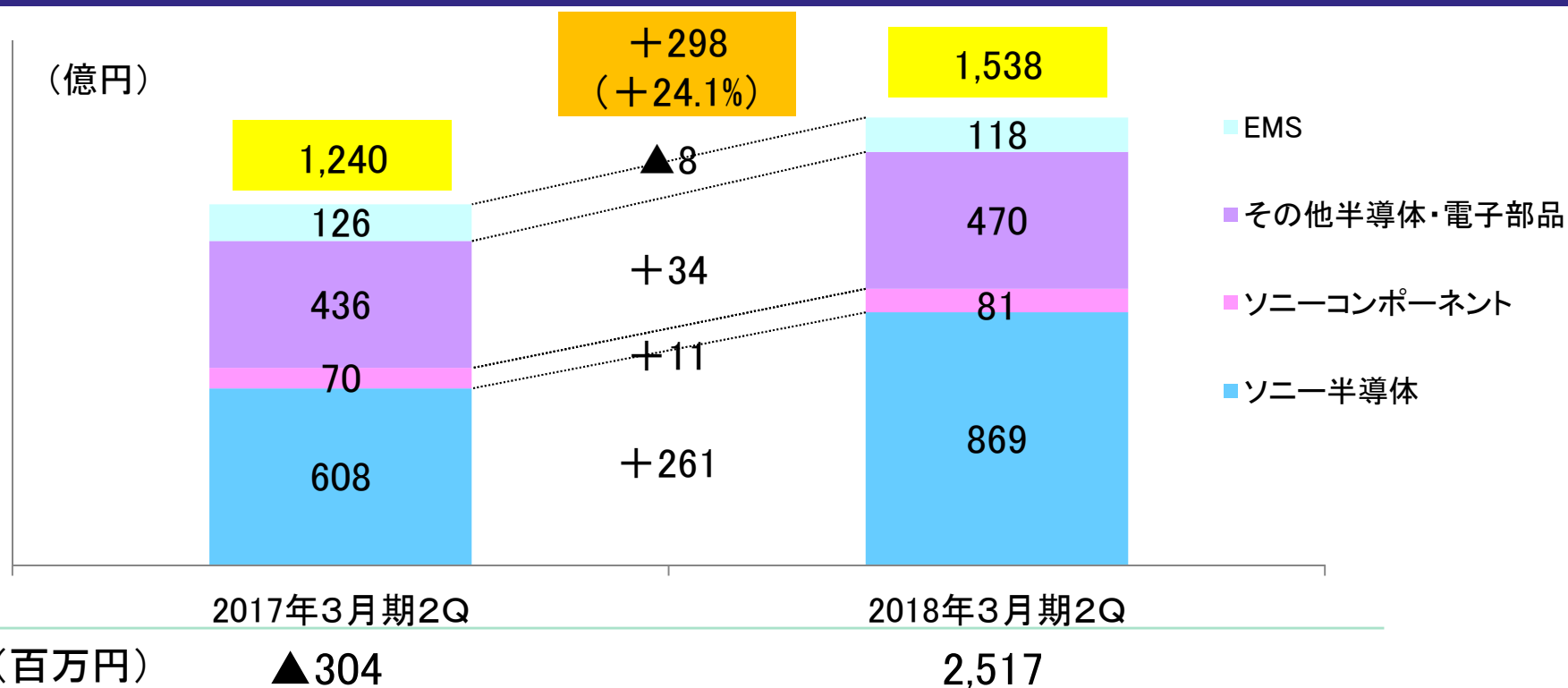


(単位:百万円)	2017年3月期2Q累計 (実績) [※]		2018年3月期2Q累計 (7月31日予想)		2018年3月期2Q累計 (実績)		前年同期比		計画比	
	金額	構成	金額	構成	金額	構成	増減金額	増減率	増減金額	増減率
売上高	131,912	100.0%	156,000	100.0%	162,532	100.0%	+30,620	+23.2%	+6,532	+4.2%
売上総利益	7,147	5.4%	8,800	5.6%	8,454	5.2%	+1,307	+18.3%	▲345	▲3.9%
SGA	7,476	5.7%	6,300	4.0%	5,795	3.6%	▲1,681	▲22.5%	▲504	▲8.0%
営業利益	△ 329	△0.2%	2,500	1.6%	2,659	1.6%	+2,989	-	+159	+6.4%
経常利益	△ 907	△0.7%	2,400	1.5%	2,520	1.6%	+3,428	-	+120	+5.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	△ 1,117	△0.8%	1,600	1.0%	1,431	0.9%	+2,548	-	▲168	▲10.5%
EPS(円)	△ 71.20		101.93		91.18					

- ▶ 売上高: 前年同期比+306億円(+23.2%) 海外スマートフォン向け半導体売上が好調、国内向けは熊本地震の影響が剥離
- ▶ 売上総利益: 前年同期比+13.1億円(売上総利益率▲0.2%) 増収効果により増加。利益率は一部在庫の評価減もあり低下
- ▶ 営業利益: 前年同期比+29.9億円
 - ・SGA: 香港の貸倒引当金繰入損が剥離
 - ・貸倒引当金については、本社特定債権管理室、香港、シンガポールの連携により、全体の額を漸減させていく方針
 - 香港では、新しいマネジメントのもと、取引先の事業動向、財務状況の再精査を行い、当該事業のコントロールと売掛金等の回収アクションプランの立案・実行中。シンガポールでは、貸倒引当金を計上した取引は中止し、取引先との返済契約締結と入金フォロー
- ▶ 経常利益: 前年同期比+34.3億円
 - 営業利益増に加え、為替差損益の改善(前年同期 425百万円差損⇒112百万円差益)もあり前年同期比増
- ▶ 親会社株主に帰属する当期純利益: 前年同期比+25.5億円
 - 香港における不適切会計関連費用(社内/第三者委員会調査、過年度決算訂正関連)の一部を過年度決算訂正関連費用として特別損失に計上(約3.6億円)。同過年度決算訂正関連費用は、7/31公表の業績予想では、SGAに織り込み(2Q累計4.5億円)

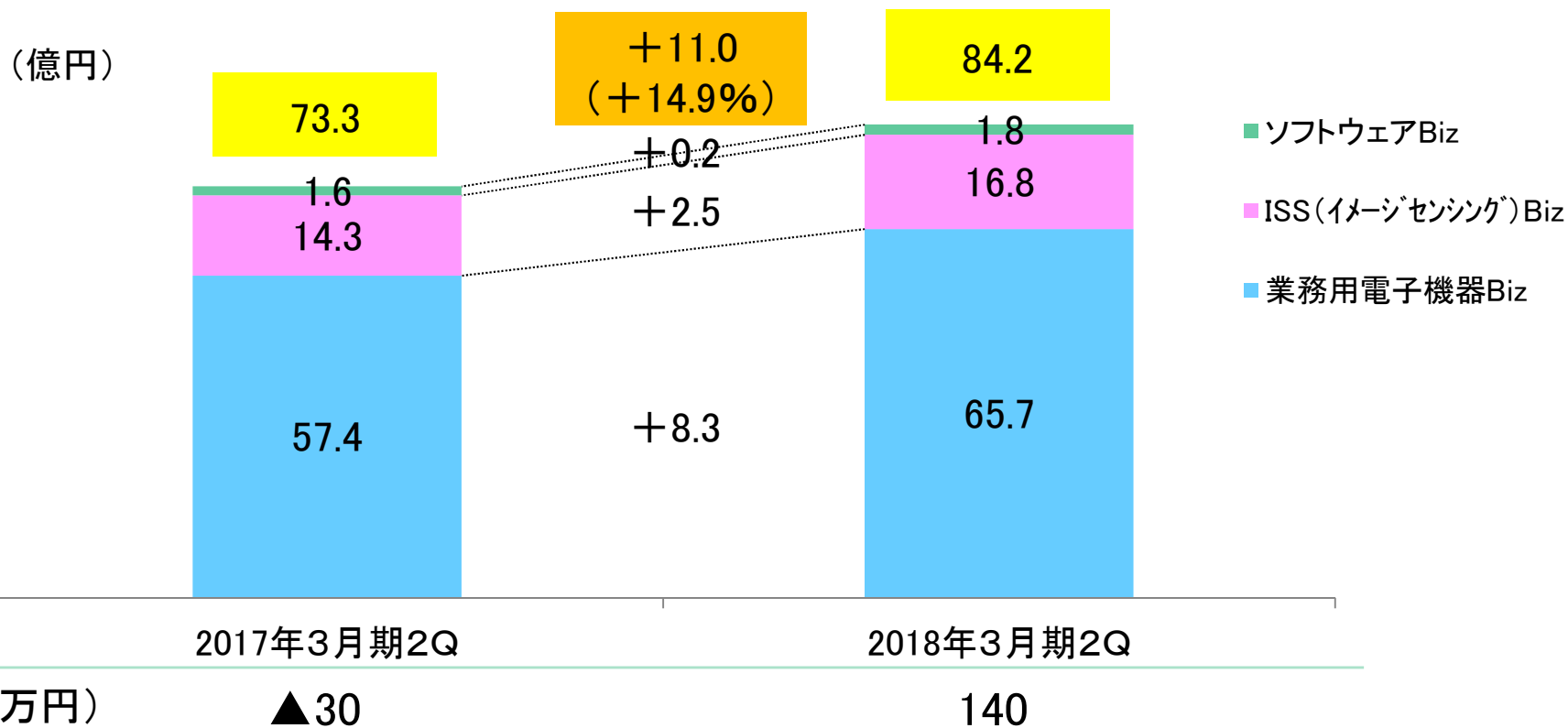
※7月31日に過年度決算訂正

2018年3月期 第2四半期 半導体及び電子部品事業



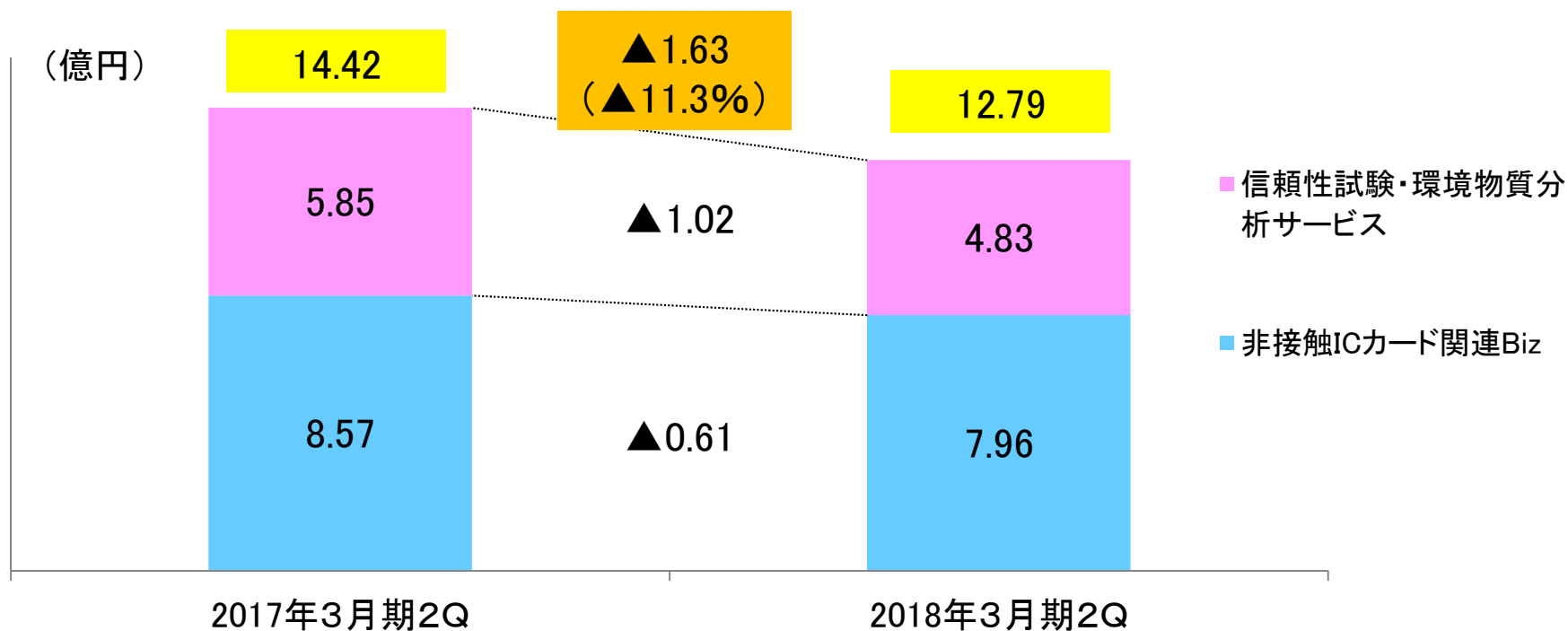
- ソニー半導体: 海外スマートフォン向けイメージセンサー好調に加えて、熊本地震の影響の剥離もあり増収
- その他半導体・電子部品: 電子材料、メモリー、車載向け中小型液晶等の売上が伸長
- EMS: ベトナム工場の稼働は好調も、中国スマートフォン向け需要の減速により、中国工場の稼働低下。事業全体の収益性は向上
- セグメント利益は増収効果に加え、前年同期の香港における貸倒引当金繰入額が剥離したことにより、黒字に転換し、利益水準は正常化

2018年3月期 第2四半期 電子機器事業



- 業務用電子機器ビジネス
大型システム案件、4K関連需要活性化等により増収
- イメージセンシングビジネス
装置メーカーの設備投資が好調なことにより増収
- 増収効果と利益率の向上により、セグメント利益を計上

2018年3月期 第2四半期 システム機器事業



セグメント利益(百万円)

93

89

- 非接触ICカード関連ビジネス
電子マネーの用途の広がりは継続しているものの、足元の需要が減速
- 半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス
車載向けの引き合いは増加しているものの、九州における大雨の影響あり
- 利益率は向上したものの、減収によりセグメント利益は微減

2018年3月期 第2四半期 財政状態(バランスシート)

(単位:百万円)	17/3月末	17/9月末
現預金	20,076	17,365
売上債権 ^{※1}	76,333	78,864
棚卸資産	20,658	25,968
貸倒引当金	-11,950	-3,210
その他	11,307	6,294
流動資産計	116,426	125,283
有形・無形固定資産	3,505	3,565
貸倒引当金	-1,528	-10,369
その他	5,834	14,869
固定資産計	7,811	8,065
総資産	124,237	133,348
仕入債務	45,562	50,359
短期借入金	32,926	38,691
1年内返済長期借入金	1,325	2,083
その他	4,008	3,178
流動負債計	83,823	94,313
長期借入金	2,300	300
その他	960	1,069
固定負債計	3,260	1,369
純資産	37,154	37,665
自己資本比率	29.6%	27.9%
BPS(円)	2,340.69	2,373.64

	前期末比	主な増減要因
総資産	+9,110	<ul style="list-style-type: none"> ・その他固定資産^{※2} +9,034百万円 ・たな卸資産 +5,310百万円 ・売上債権^{※1} +2,530百万円 ・現預金 ▲2,710百万円 ・その他流動資産^{※3} ▲5,013百万円
負債	+8,599	<ul style="list-style-type: none"> ・短期借入金 +5,764百万円 ・仕入債務 +4,797百万円 ・1年内返済予定長期借入金 +758百万円 ・未払法人税等 ▲601百万円 ・長期借入金 ▲2,000百万円
純資産	+510	<ul style="list-style-type: none"> ・親会社株主に帰属する四半期純利益 1,431百万円 ・資本剰余金からの配当 ▲470百万円 ・その他の包括利益累計額の変動額 ▲443百万円
自己資本比率	▲1.7%	総資産の増加により、低下

※2 主に、香港、シンガポールの売掛金、前渡金を固定資産に振り替えたことによる
 ※3 主に、香港の前渡金の回収による減少及び同前渡金を固定資産に振り替えたことによる

※1 電子記録債権含む

2018年3月期 第2四半期 財政状態(キャッシュ・フロー)



(百万円)	17年3月期 第2四半期	18年3月期 第2四半期	主な増減要因	
営業 CF	894	▲6,196	<ul style="list-style-type: none"> ・仕入債務の増加 ・税金等調整前四半期純利益 ・前渡金の減少 ・法人税等の支払額 ・たな卸資産の増加 ・売上債権の増加 	<ul style="list-style-type: none"> 5,338百万円 2,156百万円 1,553百万円 ▲1,181百万円 ▲5,409百万円 ▲9,071百万円
投資 CF	▲672	▲327	<ul style="list-style-type: none"> ・投資有価証券の取得 ・有形固定資産の取得 	<ul style="list-style-type: none"> ▲62百万円 ▲215百万円
財務 CF	2,657	3,709	<ul style="list-style-type: none"> ・短期借入金の純増 ・配当金の支払額 ・長期借入金の減少 	<ul style="list-style-type: none"> 5,484百万円 ▲470百万円 ▲1,235百万円
現金及び 現金同等物	23,990	16,565		





2018年3月期 通期連結業績予想

2018年3月期 通期連結業績予想

(単位:百万円)	2017年3月期通期		2018年3月期第2四半期累計 (実績)			2018年3月期通期 (7月31日予想)		
	金額	構成	金額	構成	進捗率	金額	構成	前年比
売上高	273,752	100.0%	162,532	100.0%	54.2%	300,000	100.0%	+9.6%
売上総利益	16,012	5.8%	8,454	5.2%	48.3%	17,500	5.8%	+9.3%
SGA	22,615	8.3%	5,795	3.6%	48.3%	12,000	4.0%	▲46.9%
営業利益	△ 6,603	△2.4%	2,659	1.6%	48.4%	5,500	1.8%	-
経常利益	△ 7,385	△2.7%	2,520	1.6%	49.4%	5,100	1.7%	-
親会社株主に帰属 する四半期純利益	△ 8,688	△3.2%	1,431	0.9%	42.1%	3,400	1.1%	-
EPS(円)	△ 553.49		91.18			216.60		

- 第2四半期累計連結業績は、海外スマートフォン向け半導体売上が好調に推移したことから、売上高は期初予想を上回ったものの、一部製品の評価減の影響等もあり四半期純利益は期初予想を下回った
- 下期は、海外スマートフォン向け販売は減速も、電子機器事業やEMS事業により利益確保を図る
- 10月20日に公表したサムスングループ向けのソニー半導体販売の終了は12月末を予定
バッテリー事業の拡大や事業の高付加価値化により、来期業績への影響の軽減、最小化を図る
- コーポレートガバナンス、コンプライアンス強化に向けた各種施策を推進中
- 配当予想は、第2四半期末、期末ともに修正の予定なし(第2四半期末30円、期末30円)



株式会社 UKCホールディングス

〈お問い合わせ先〉

経営企画部門 大澤

Mail to: ir@ukcgroup.com

本資料中のデータや将来予測は、資料作成時点における当社の判断や入手可能なデータに基づくもので、今後様々な要因によって変化することがあり、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。